

【応募要領】

半導体産業技術交流会 提案企業の募集について

本資料は、フェニテックセミコンダクター株式会社をニーズ発信企業とする半導体産業技術交流会（以下「技術交流会 2025 in フェニテックセミコンダクター」という。）へのエントリーについてのご案内です。積極的なご提案をお待ちしております。

なお、ご提案頂いた内容は、技術交流会とその後のマッチング以外の目的で利用することはありませんので、可能な範囲で詳細にご記入下さい。

また、皆様の連絡先は、関連事業（セミナーやワークショップのご案内など）に使用させて頂く場合がございますが、それ以外でご本人の同意なく第三者に開示・提供することはございません。

1. 概要

中国地域半導体関連産業振興協議会では、ニーズを有する大手半導体関連企業（以下、「ニーズ発信企業」とする。）に対して技術を持つ企業が提案を行うことで、相互の交流・連携の「きっかけ」づくりをサポートするための商談イベント「技術交流会」を開催しています。

このたび、フェニテックセミコンダクター株式会社をニーズ発信企業とする「技術交流会 2025 in フェニテックセミコンダクター」を開催します。

つきましては、ニーズに対する技術提案を行う企業等（以下、「提案企業」とする。）の募集を行いますので、本要領をご確認いただき、是非、応募していただきますよう、ご案内申し上げます。

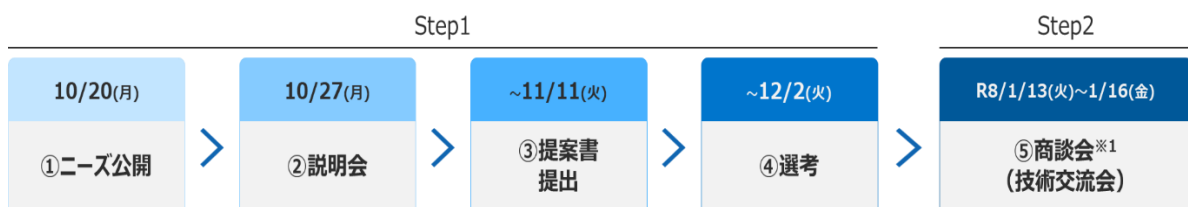
令和8年1月13日（火）～1月16日（金）（うち2日間開催予定）の商談会に参加していただくためには、下図のとおり、Step1の手続をパスしていただくことが必要です。

Step1では、10月27日（月）13:00に開催する説明会を踏まえて、11月11日（火）までに提案書を提出して選考を受けていただきます。

選考をパスされた場合は、令和8年1月13日（火）～1月16日（金）（うち2日間開催予定）の商談会に参加していただくことができます。

なお、ご提案の際には、別紙の「ニーズ概要」を参考にしてください。

【当日までの流れ】



※1 詳細な日程・時刻は、一次選考後のご案内となります。

2. 参加申込み対象

提案企業として参加申込みが可能な企業等は、以下の国が関係する半導体関連の協議会・コンソーシアム（以下、「地域コンソ」とする。）の会員です。現時点で、何れの地域コンソの会員でもない場合は、事前に入会等の手続きをお願いいたします。

※各地域コンソには入会要件が設定されている場合がございますので事務局にご確認ください。なお、貴社の本社、工場、事業所等がある地域に地域コンソが設立されていない場合や入会が難しい場合等は、中国地域半導体関連産業振興協議会にご入会ください。全国の企業等を対象に会員を募集しています。

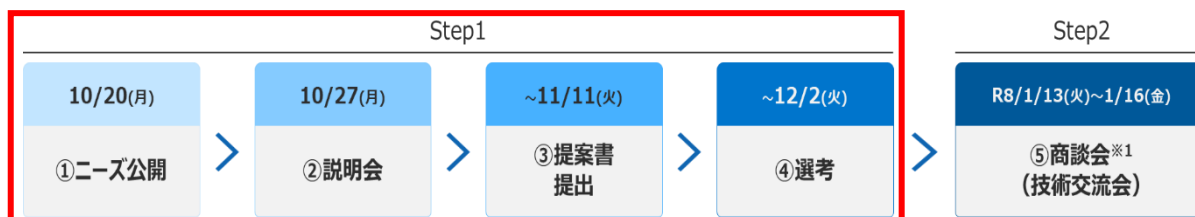
■ 中国地域半導体関連産業振興協議会 https://www.chugoku.meti.go.jp/seisaku/tiiki/handoutaikanrensangyou.html 【問い合わせ先】 中国経済産業局 地域経済部 半導体関連産業室 電話：082-224-5709 E-mail：bzl-monozukuri02@meti.go.jp
■ 北海道半導体人材育成等推進協議会 https://www.hkd.meti.go.jp/hokcm/semiconductor/index.htm
■ 東北半導体・エレクトロニクスデザインコンソーシアム（T-Seeds） https://t-seeds.jp/
■ 関東半導体人材育成等連絡会議 https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iot_robot/digital_industry/index.html
■ 中部地域半導体人材育成等連絡協議会 https://www.chubu.meti.go.jp/c31seizo/semicon/index.html
■ 関西半導体人材育成等連絡協議会 https://www.kansai.meti.go.jp/3jisedai/semicon/consortium.html
■ 九州半導体人材育成等コンソーシアム https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/jyoho/electronics.html
■ 九州半導体・デジタルイノベーション協議会（SIIQ） https://siiq.or.jp

3. 全体の流れ

ここからは、Step1～Step 2 の順に、全体の流れを説明します。

(1) Step1 について

【当日までの流れ】



※1 詳細な日程・時刻は、一次選考後のご案内となります。

①「ニーズ公開」②「説明会」

10月27日(月)13:00に、オンラインで「説明会」を開催します。

本説明会では、ニーズ発信企業であるフェニテックセミコンダクター株式会社から、同社の会社紹介やニーズ（技術交流会 2025 in フェニテックセミコンダクターでの提案を希望する内容）の概要を説明します。「説明会」に参加しなくても、提案書を提出できますが、同社のニーズに適した提案をしていただくためにも、是非、参加してください。

説明会に参加を希望される方は、次の申込みフォームより参加者の登録をお願いします。登録完了後、説明会参加用の URL を記載した登録完了メールを送信します。

<https://hirogin-areadesign.smktg.jp/public/seminar/view/2972>



③「提案書提出」

別紙の「提案書」を記載して、11月11日（火）までに、次の応募専用サイトから事務局宛てに送信してください。提案書は、ニーズ発信企業による選考資料ですので、可能な範囲で具体的な記入をお願いします。

提出物：提案書

作成要領：i 提出物は提案書のみです。付属資料がある場合は、提案書の巻末にページを追加して、付属資料を貼り付けて提出してください。

ii **提案書のデータ容量は 5MB 以内とし、ファイル名は「技術交流会 2025 in フェニテックセミコンダクター 提案書（〇〇社）.docx」**にしてください。応募専用サイトは、5MB を超える書類を受信できませんので、宜しくお願いいたします。

iii 提案書は **WORD ファイルで提出**してください（PDF 等に変換しないでください）。

iv 応募要領（別紙）に記載されたニーズに対応していない提案も可能ですが、半導体チップ製造に関する提案に限らせて頂きます。また、ニーズに対応した提案を中心に選考作業が進む可能性が高いことをご了承ください。

v 提案書は、機密情報を含まない公開情報のみで作成してください。

提出期間：2025 年 10 月 20 日（月）～**11 月 11 日（火）17:00（必着）**

提出先：応募専用サイトから送信してください。

<https://hirogin-areadesign.smktg.jp/public/seminar/view/2971>



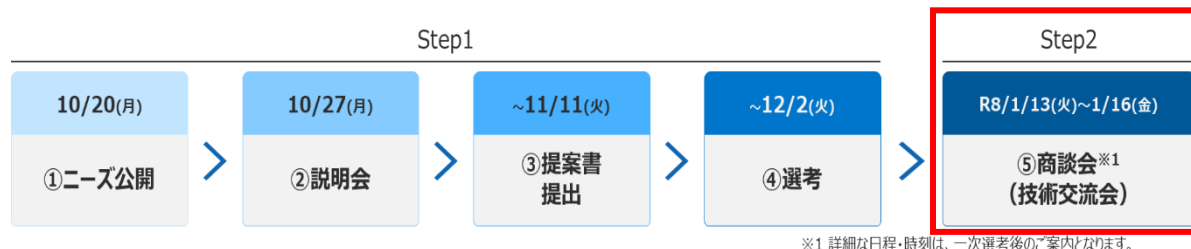
送付頂いた資料は、ニーズ発信企業その他、所属している地域コンソに提出することがあります。予めご了承ください。

④選考

フェニテックセミコンダクター株式会社が提案書を確認し、Step2 に進む提案企業を選考します。選考の結果、提案書を提出していただいたにも関わらず、Step2 に進むことができない場合がある点ご了承ください。選考結果は、提案書を提出していただいた全ての企業等に、12 月 2 日（火）までに通知する予定です。なお、選考理由に関するお問い合わせには応じかねます。

（２）Step2 について

【当日までの流れ】



前述の選考をパスした提案企業に対して、事務局から技術交流会の詳細な案内（商談時間、会場等）をご連絡します。

技術交流会にご参加いただく企業には、事前に機密保持契約を締結いただく必要があります。あらかじめご承知のうえ、ご参加ください。契約の締結については、後日ご連絡させていただきます。

⑤商談会（技術交流会）

日時：令和 8 年 1 月 13 日（火）～1 月 16 日（金）（うち 2 日間開催予定）

恐れ入りますが、ご提案にあたって当該日程においてご予約確保の対応をお願い申し上げます。

具体的な商談時間の調整は選考パスの通知時にご連絡させていただきます。

場所：フェニテックセミコンダクター株式会社（岡山県井原市木之子町 6833 番地）

※現地参加のみといたします。

商談方法：提案企業一社あたり 50 分程度（質疑応答時間を含む）

※商談は個室で実施します。（商談会形式の場合）

※商談の個室に、本技術交流会の事務局が同席する場合があります。

参加費：無料

4. その他

技術交流会の後日、商談結果のアンケートを取らせていただきますので、ご協力をお願いします。

5. 技術交流会に関する問い合わせ先

技術交流会業務受託機関：ひろぎんエリアデザイン(株)

(E-Mail) semicon@hirogin.co.jp

(TEL) 080-9954-7846, 080-9954-7833, 080-1923-9700

※可能な限りメールでのお問い合わせをお願いいたします。

本技術交流会は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「特定半導体の安定供給体制の構築・維持に必要な中国地域のサプライチェーン強靱化に関する調査」の一環で実施します。